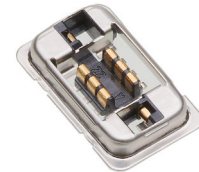


5Gミリ波RF FPC対基板用コネクタ、 0.35mmピッチ、5G25シリーズ

モレックスの5G25 RFコネクタは、高周波信号（25 GHz）をサポートする一方で、モレックス独自のコンタクトシールドとRF端子を隔離させることにより、5Gアプリケーションに必要な、高レベルのシグナルインテグリティ（SI）性能を維持しています。



リセプタクル



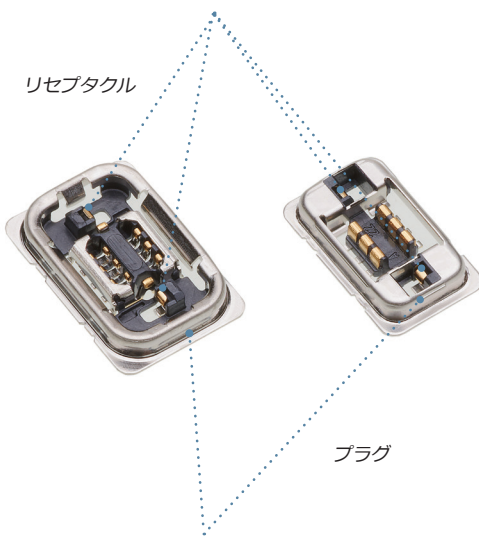
プラグ

5Gミリ波RF FPC対基板用コネクタ、
0.35mmピッチ、0.70mm嵌合高さ、
5G25シリーズ

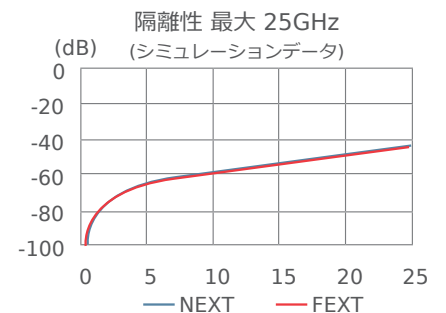
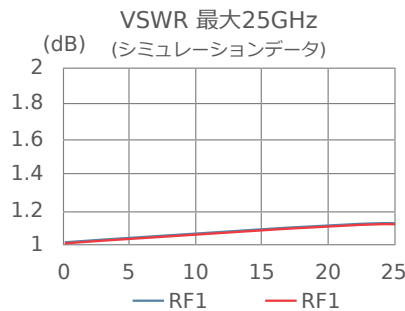
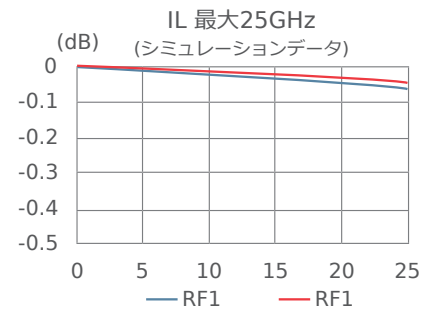
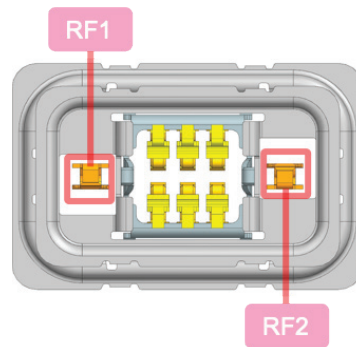
特徴・利点

RF端子の独自のコンタクト設計

省スペース、堅牢性を備えながら高速化を実現



優れたシールド設計により、業界最高水準の
25GHzまでのSI性能を実現

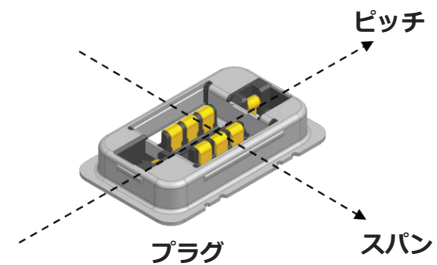
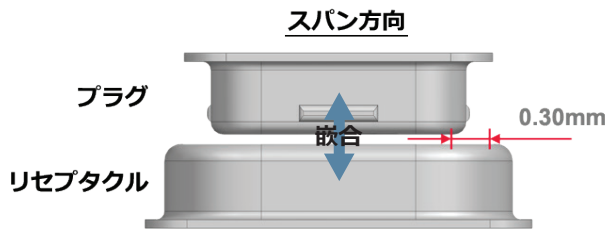
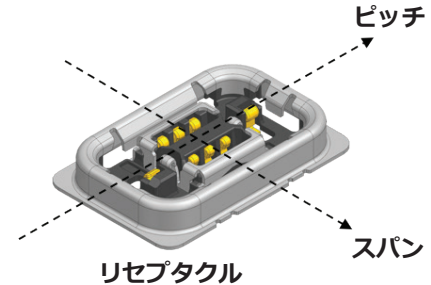
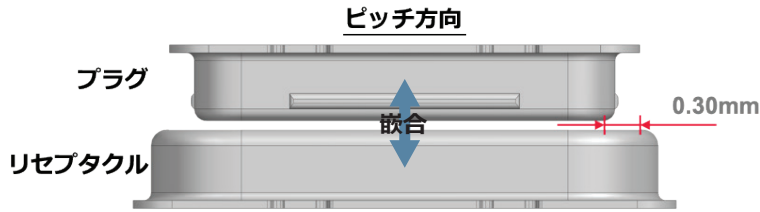


独自設計のシールド

完全なEMI シールドと高周波対応で、優れた能力を提供嵌合位置を確保しながら優れたEMI 低減とSI性能を実現し、偶発的な落下によるRF接点の座屈と衝撃から保護

5Gミリ波RF FPC対基板用コネクタ、 0.35mmピッチ、5G25シリーズ ▶

0.30mm (ピッチ) / 0.30mm (スパン) の幅広いアライメント公差により、適切なアライメントと嵌合が可能



市場・アプリケーション

コンシューマー

スマートフォン
タブレットPC
ウェアラブル機器
スマートホーム機器
AR/VRデバイス

産業

IoT
ポータブルオーディオおよびナビゲーション機器
5GデバイスおよびRFデバイス

医療機器

患者モニタリング装置
治療用機器および手術装置機器

防衛

ドローン
自動運転車両
航空電子機器



ドローン



IoT



5Gデバイス、タブレット、
モバイル機器



AR/VR



患者モニタリング

5Gミリ波RF FPC対基板用コネクタ、 0.35mmピッチ、5G25シリーズ >

仕様

参考情報

梱包形態：エンボステープ、カバー付き

寸法単位: mm

RoHS：ハロゲンフリー：適合

電気的特性

最大定格電圧：50V

電流信号端子（最大）。1.0A/ピン

最大接触抵抗：

信号端子：30mΩ

RF端子：20mΩ

耐電圧：250V AC

最小絶縁抵抗：100MΩ

機械的特性

ピッチ: 0.35mm

嵌合高さ: 0.70mm (幅) : 2.76mm

時間: 4.16mm

構造タイプ: 垂直型

極数/信号6/RF-2

最大耐久挿抜回数：10回

物理的特性

ハウジング：LCP (黒)、UL 94V-0

信号端子：銅合金

RF端子：銅合金

シールド: 銅合金

GNDカバー：銅合金

メッキ：

信号端子/RF端子グランドカバー

接点部 — 金

テール部 — 金

アンダー — ニッケル

使用温度範囲：-40～+85°C

www.molex.com/link/5gmmwave.html

www.molex.com/link/SlimStack.html

www.japanese.molex.com/link/5gmmwave.html

www.japanese.molex.com/link/SlimStack.html